



2019年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

2019年1月31日

上場会社名 東京エレクトロン株式会社

上場取引所 東

コード番号 8035 URL <https://www.tel.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 河合 利樹

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 笹川 謙

TEL 03-5561-7000

四半期報告書提出予定日 2019年2月13日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2019年3月期第3四半期の連結業績(2018年4月1日～2018年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2019年3月期第3四半期	959,204	23.8	234,154	29.1	241,907	34.1	184,126	40.1
2018年3月期第3四半期	774,750	43.7	181,411	92.7	180,426	88.5	131,384	93.4

(注) 包括利益 2019年3月期第3四半期 176,536百万円 (22.4%) 2018年3月期第3四半期 144,220百万円 (110.3%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2019年3月期第3四半期	1,122.61	1,117.90
2018年3月期第3四半期	800.71	797.98

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2019年3月期第3四半期	1,171,447	821,906	69.5
2018年3月期	1,202,796	771,509	63.8

(参考) 自己資本 2019年3月期第3四半期 814,478百万円 2018年3月期 767,146百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2018年3月期		277.00		347.00	624.00
2019年3月期		413.00			
2019年3月期(予想)				311.00	724.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2019年3月期の連結業績予想(2018年4月1日～2019年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	1,280,000	13.2	309,000	9.9	315,000	12.2	237,000	16.0	1,445.13

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

詳細は、「添付資料」9ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

2019年3月期3Q	165,210,911 株	2018年3月期	165,210,911 株
------------	---------------	----------	---------------

期末自己株式数

2019年3月期3Q	1,264,296 株	2018年3月期	1,097,342 株
------------	-------------	----------	-------------

期中平均株式数(四半期累計)

2019年3月期3Q	164,015,985 株	2018年3月期3Q	164,083,989 株
------------	---------------	------------	---------------

(注) 期末自己株式数には、「役員報酬BIP信託」及び「株式付与ESOP信託」が保有する当社株式(2019年3月期3Q 252,300株)を含めております。また、各信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式を含めております。

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、「添付資料」4ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

・当社は、2019年1月31日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布する決算説明資料につきましては、当社ホームページに掲載する予定です。

【添付資料】

[目次]

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	9
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	9
(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)	9
(追加情報)	9
(四半期連結損益計算書関係)	9
(セグメント情報等)	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間につきましては、中国において経済成長率の鈍化が見られるものの、米国をはじめとして世界経済は堅調に推移しております。

当社グループが参画するエレクトロニクス産業におきましては、データセンター向け投資やスマートフォン需要の調整により、半導体出荷量の拡大に減速傾向が見られるものの、中長期においては、人工知能(AI)、次世代通信規格など新たな技術の進展を背景に半導体需要の拡大が見込まれております。

このような状況のもと、当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高9,592億4百万円(前年同期比23.8%増)、営業利益2,341億5千4百万円(前年同期比29.1%増)、経常利益2,419億7百万円(前年同期比34.1%増)、また、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,841億2千6百万円(前年同期比40.1%増)となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりです。

① 半導体製造装置

データセンターやスマートフォン需要の鈍化傾向を背景に、メモリメーカーの一部において設備投資計画の見直しが行われるなど、半導体製造装置市場は足元では調整局面に入っておりますが、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、8,779億8千2百万円(前年同期比20.4%増)となりました。

② FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置

中国におけるテレビ用大型液晶パネル向けの設備投資に加え、スマートフォン用中小型有機ELパネル向けの設備投資も継続して行われ、FPD製造装置市場は好調に推移しました。このような状況のもと、当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、810億6千6百万円(前年同期比79.0%増)となりました。

③ その他

当セグメントの当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高は、1億5千4百万円(前年同期比49.4%減)となりました。

(ご参考)

【連結業績】

(単位：百万円)

	当期			
	第1Q	第2Q	第3Q	第3Q累計
売上高	295,569	395,465	268,169	959,204
半導体製造装置	280,400	358,057	239,525	877,982
日本	51,146	58,048	54,095	163,291
北米	28,496	45,910	22,767	97,174
欧州	17,755	31,345	18,613	67,714
韓国	88,986	86,558	60,960	236,505
台湾	26,315	48,057	29,384	103,757
中国	54,964	71,306	38,099	164,370
東南アジア他	12,734	16,830	15,604	45,169
F P D 製造装置	15,113	37,354	28,598	81,066
その他	55	53	46	154
営業利益	72,418	103,000	58,735	234,154
経常利益	75,212	106,034	60,660	241,907
親会社株主に帰属する 四半期純利益	55,741	79,553	48,831	184,126

(注) セグメント間取引については、相殺消去しております。

(2) 財政状態に関する説明

① 財政状態

当第3四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ368億8千8百万円減少し、9,097億8百万円となりました。主な内容は、有価証券に含まれる短期投資の減少695億円、未収消費税等の減少192億8百万円、受取手形及び売掛金の減少148億1千1百万円、現金及び預金の増加368億6百万円、たな卸資産の増加242億2千2百万円によるものであります。

有形固定資産は、前連結会計年度末から162億8千9百万円増加し、1,422億4千2百万円となりました。

無形固定資産は、前連結会計年度末から59億3千3百万円減少し、99億4千8百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末から48億1千7百万円減少し、1,095億4千7百万円となりました。

これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から313億4千9百万円減少し、1兆1,714億4千7百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ831億4千2百万円減少し、2,853億1千万円となりました。主として、未払法人税等の減少485億4千6百万円、支払手形及び買掛金の減少189億6千3百万円、賞与引当金の減少151億8千8百万円によるものであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ13億9千6百万円増加し、642億3千万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ503億9千6百万円増加し、8,219億6百万円となりました。主として、親会社株主に帰属する四半期純利益1,841億2千6百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当及び当期の中間配当1,247億5千4百万円の実施による減少によるものであります。この結果、自己資本比率は69.5%となりました。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、上記の前期末比較については、当該会計基準等を遡って適用した後の前連結会計年度末の数値で比較しております。

② キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当第3四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ891億9千3百万円減少し、1,686億8千4百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資1,725億円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ326億9千3百万円減少し、3,411億8千4百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ261億円増加の1,245億9百万円の収入となりました。主な要因につきましては、税金等調整前四半期純利益2,417億円、未収消費税等の減少191億9千万円、減価償却費169億8千3百万円、売上債権の減少135億8千6百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額1,029億1千5百万円、たな卸資産の増加280億8千3百万円、仕入債務の減少178億6千万円、賞与引当金の減少150億2千万円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として定期預金及び短期投資の増加による支出565億円、有形固定資産の取得による支出329億1千4百万円により、前年同期の409億8千6百万円の収入に対し820億4千5百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払1,247億5千4百万円により、前年同期の825億4千4百万円の支出に対し1,297億6千万円の支出となりました。

【連結キャッシュ・フロー(要約)】

(単位：百万円)

	前第3四半期 連結累計期間	当第3四半期 連結累計期間
営業活動によるキャッシュ・フロー	98,409	124,509
税金等調整前四半期純利益	179,627	241,700
減価償却費	14,531	16,983
売上債権の増減額(△は増加)	△16,642	13,586
たな卸資産の増減額(△は増加)	△94,407	△28,083
仕入債務の増減額(△は減少)	13,505	△17,860
その他	1,794	△101,816
投資活動によるキャッシュ・フロー	40,986	△82,045
定期預金及び短期投資の増減額(△は増加)	75,000	△56,500
その他	△34,013	△25,545
財務活動によるキャッシュ・フロー	△82,544	△129,760
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,023	△1,897
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	60,875	△89,193
現金及び現金同等物の期首残高	164,366	257,877
現金及び現金同等物の四半期末残高	225,241	168,684
現金及び現金同等物並びに満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超える定期預金及び短期投資の四半期末残高	301,241	341,184

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2019年3月期の連結業績予想につきましては、前回発表時(2018年10月31日)の見通しを変えておりません。

※この決算短信に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、国内及び諸外国の経済状況、各種通貨の為替レートの変動、業績に影響を与えるその他の要因等現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。これらは、市況、競争状況、新製品の導入及びその成否、並びに半導体関連業界の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の売上高及び利益は、この決算短信に記載されている予想数値とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	87,377	124,184
受取手形及び売掛金	159,570	144,759
有価証券	286,500	217,000
商品及び製品	220,497	238,354
仕掛品	75,504	74,652
原材料及び貯蔵品	48,069	55,285
その他	69,137	55,563
貸倒引当金	△59	△91
流動資産合計	946,597	909,708
固定資産		
有形固定資産	125,952	142,242
無形固定資産		
その他	15,882	9,948
無形固定資産合計	15,882	9,948
投資その他の資産		
その他	115,786	110,972
貸倒引当金	△1,422	△1,424
投資その他の資産合計	114,364	109,547
固定資産合計	256,199	261,738
資産合計	1,202,796	1,171,447

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2018年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	108,607	89,643
未払法人税等	66,046	17,500
前受金	100,208	96,228
賞与引当金	34,467	19,279
製品保証引当金	11,284	13,605
その他の引当金	4,618	3,850
その他	43,218	45,202
流動負債合計	368,452	285,310
固定負債		
その他の引当金	374	1,259
退職給付に係る負債	59,309	59,846
その他	3,150	3,124
固定負債合計	62,834	64,230
負債合計	431,287	349,541
純資産の部		
株主資本		
資本金	54,961	54,961
資本剰余金	78,011	78,011
利益剰余金	625,390	684,729
自己株式	△7,518	△11,936
株主資本合計	750,843	805,765
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	17,134	8,760
繰延ヘッジ損益	278	10
為替換算調整勘定	5,507	4,999
退職給付に係る調整累計額	△6,618	△5,058
その他の包括利益累計額合計	16,302	8,712
新株予約権	4,363	7,427
純資産合計	771,509	821,906
負債純資産合計	1,202,796	1,171,447

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
売上高	774,750	959,204
売上原価	453,261	565,312
売上総利益	321,488	393,891
販売費及び一般管理費		
研究開発費	70,018	83,889
その他	70,058	75,848
販売費及び一般管理費合計	140,077	159,737
営業利益	181,411	234,154
営業外収益		
受取配当金	325	1,790
為替差益	—	2,490
その他	1,912	3,651
営業外収益合計	2,237	7,931
営業外費用		
閉鎖拠点維持管理費用	56	55
為替差損	2,986	—
その他	178	122
営業外費用合計	3,222	178
経常利益	180,426	241,907
特別利益		
固定資産売却益	72	52
特別利益合計	72	52
特別損失		
固定資産除売却損	335	257
投資有価証券評価損	536	—
その他	—	1
特別損失合計	871	259
税金等調整前四半期純利益	179,627	241,700
法人税等	48,214	57,574
四半期純利益	131,412	184,126
非支配株主に帰属する四半期純利益	28	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	131,384	184,126

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)
四半期純利益	131,412	184,126
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	6,960	△8,362
繰延ヘッジ損益	△177	△262
為替換算調整勘定	6,717	△539
退職給付に係る調整額	△693	1,518
持分法適用会社に対する持分相当額	0	57
その他の包括利益合計	12,807	△7,589
四半期包括利益	144,220	176,536
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	144,191	176,536
非支配株主に係る四半期包括利益	29	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用の計算

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)

該当事項はありません。

(追加情報)

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(四半期連結損益計算書関係)

法人税等

過年度における当社と韓国子会社との間の移転価格税制に基づく更正処分について、日韓両国の税務当局間の相互協議が合意に向けて進展し、二重課税が解消される見込みとなりました。これに伴い想定される還付額と、過年度において計上していた還付見込額との差額△647百万円を、当第3四半期連結累計期間の「法人税等」に含めて表示しております。

(セグメント情報等)

① 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、BU(ビジネスユニット)を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「半導体製造装置」及び「FPD(フラットパネルディスプレイ)製造装置」を報告セグメントとしております。

「半導体製造装置」の製品は、ウェーハ処理工程で使われるコータ/デベロッパ、エッチング装置、成膜装置、洗浄装置、ウェーハ検査工程で使われるウェーハプローバ及びその他半導体製造装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

「FPD製造装置」の製品は、フラットパネルディスプレイ製造用のコータ/デベロッパ、エッチング/アッシング装置から構成されており、これらの開発・製造・販売・保守サービス等を行っております。

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント		その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 3
	半導体 製造装置	FPD 製造装置				
売上高	877,982	81,066	14,338	973,388	△14,183	959,204
セグメント利益	244,990	17,837	88	262,916	△21,216	241,700

(注) 1. 「その他」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社グループの物流・施設管理・保険業務等であります。

2. セグメント利益の調整額△21,216百万円は、報告セグメントに帰属しない当社における基礎研究又は要素研究等の研究開発費△11,951百万円、及びその他の一般管理費等であります。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益と調整を行っております。

③ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。